

烟台德邦科技股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：深圳德邦界面材料有限公司（以下简称“深圳德邦”），系烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额：公司本次拟担保总额不超过 15,000 万元，截至本公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 22,500 万元、公司对控股子公司提供的担保总额 22,500 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例 9.81%、7.58%。
- 本次担保无反担保。
- 本次为全资子公司申请综合授信提供担保的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足项目建设的资金需求，确保项目顺利推进，深圳德邦拟向银行申请综合授信额度，授信金额不超过 15,000 万元，授信期限不超过 10 年。深圳德邦将以固定资产（包括所购置的土地及建成的厂房）进行抵押，公司拟为深圳德邦本次借款提供全额担保，具体担保条款以最终签署的正式担保合同为准。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

在提交董事会议审议之前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）深圳德邦界面材料有限公司

1、成立日期：2010年11月16日

2、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路88号4号厂房102、202、301

3、法定代表人：CHEN TIAN AN

4、经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：界面材料、导电材料、电子材料、绝缘材料、导热材料的研发、生产与销售。

5、深圳德邦为公司持股100%的全资子公司。

6、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	11,902.56
负债总额	4,492.56
净资产	7,410.00
项目	2024年12月31日（经审计）
营业收入	11,291.89
净利润	1,325.13
扣除非经常性损益后的净利润	1,150.92

以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、为确保借款合同的顺利签署，深圳德邦除以固定资产抵押外，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳德邦信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司和深圳德邦尚未签订相关担保及授信协议，上述综合授信计划额度及担保总额，分别仅为深圳德邦拟申请的综合授信规模和公司拟为其提供的担保额度。具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核确认，最终以各方实际签署的正式合同为准。

四、担保的原因及必要性

深圳德邦作为公司全资子公司，为满足募投项目“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的资金需求，拟向银行申请贷款。公司为深圳德邦的综合授信提供担保，有利于提升子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略。作为深圳德邦的控股股东，公司能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意该议案。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及其下属子公司的业务拓展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请预计担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 22,500 万元、公司对控股子公司提供的担保总额 22,500 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例 9.81%、7.58%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

